陶氏電子材料榮獲新產品介紹獎

AUROLECTROLESS™ SMT 520 浸金贏得印刷電路設計與製造雜誌

之最佳表面處理新產品獎

高性能和具成本效益的解決方案將在 Circuitex 蘇州展覽會上亮相

中國上海 2011 年 5 月 10 日訊 **–** 陶氏化學公司（NYSE:DOW）旗下的電子材料事業群近日因其用於印刷電路板製造的 AUROLECTROLESS™ SMT 520 浸金解決方案而獲得印刷電路設計與製造（PCD&F）雜誌頒發的新產品介紹（NPI）獎。為因應原材料成本上漲的挑戰，透過減少使用貴金屬，該性能增強型產品能夠提供成本優勢。在即將舉行的 Circuitex 蘇州展覽會上，該公司將以“一種新的化學鍍鎳浸金（ENIG）工藝在 PCB 中的應用”為題進行簡報，並將展出該產品及其它解決方案。

“陶氏電子材料的新產品可在低金鹽濃度下進行操作，從而減少化學鍍鎳浸金（ENIG）和電鍍化學鍍鎳鈀浸金（ENEPIG）工藝中對金的消耗量，在表面處理項目中被評選為最創新之產品。”印刷電路設計與製造雜誌的主編 Mike Buetow 說。AUROLECTROLESS™ SMT 520 浸金是一種非常具有成本效益的新型最終表面處理產品，能夠提供可焊接性、打線結合和防腐保護。該產品具有出色的沉積覆蓋能力，從而可以在後續工藝步驟中增加抗腐蝕性。這是 NPI 獎項設立第四年，此獎項主要目的為表彰過去一年中居於領先地位的新產品，評審為來自產業的一群獨立的工程師。

“陶氏電子材料堅信充滿熱情與客戶共同創新以創造互連世界。此獎項證明了我們有實力成為客戶可靠的合作夥伴，來創造更好的技術，以及解決問題與挑戰，”陶氏電子材料事業群電子互連技術事業部全球總經理張巍說。“我們在產業科技上的專業、遍佈全球的據點和以及在市場迅速應變的能力，是我們能夠為客戶提供創新技術和產品，與客戶共創電子產業未來的關鍵。”

該公司將在 Circuitex 蘇州展覽會上展示的其它新的解決方案包括：

在電解電鍍方面，陶氏新一代厚板銅鍍已經研發成功，提高了厚板電鍍（厚度超過 3.2 毫米）的均鍍能力。**高速直流電銅鍍產品**可應用於細小孔徑高縱橫比和微盲孔電路板，能夠在電鍍密度增加的情況下仍維持很好的勻鍍能力。**全新先進電解電鍍錫**旨在提高耐腐蝕能力，並能提高表面均勻，降低整體成本。所有這些產品都有助於提高電鍍效率，能在無需客戶投資額外的設備的情形下，實現更高的生產產出。

在除膠渣方面，新產品 CIRCUPOSIT™通孔製備 4126 全新先進膨鬆劑在膠渣除污方面具有極佳的清潔性能，能夠提供出色的表面質地，提高無電鍍銅沉積的可靠性。憑藉最適化後的簡單工藝和低濃度溶液，該產品能提供具有成本效益和永續發展能力的優勢。全新先進膨鬆劑能夠適用於普通和高性能板材，操作範圍廣泛。

Circuitex 蘇州展覽會將於 2011 年 5 月 11 日至 13 日在位於蘇州工業園區現代大街的蘇州國際博覽中心舉辦，陶氏電子材料在 Circuitex 蘇州展覽會上的展位是 AW09。

陶氏電子材料研發人員 Martin Bayes（左）代表公司從 PCD&F 雜誌編輯 Mike Buetow（右）手中接過 NPI 獎。

關於陶氏化學公司

陶氏是一家多元化的化學公司，運用科學、技術以及”人元素”力量不斷改進推動人類進步的基本要素。公司將永續原則貫穿於化學與創新，致力於解決當今世界的諸多挑戰，如滿足清潔水的需求、實現可再生能源的生產、提高農作物產量等。陶氏以其領先的特種化學、高新材料、農業科學和塑膠等業務，為全球 160 個國家和地區的客戶提供種類繁多的產品及服務，應用於電子產品、水處理、能源、塗料和農業等高速發展的市場。陶氏 2010 年銷售額為 537 億美元，在全球擁有約 50,000 名員工，在 35 個國家營運 188 個生產基地，產品達 5000 多種。除特別註明外，"陶氏"或"公司"均指陶氏化學公司及其附屬公司。有關陶氏的進一步資料，請瀏覽陶氏網頁 www.dow.com.cn 以及 www.dow.com。

關於陶氏電子材料

陶氏電子材料是全球電子產業的材料和技術供應商，引領半導體、電子互連、表面處理、太陽能電池、顯示器、LED 和光學產品領域的發展。透過分佈在世界各地的技術中心，陶氏優秀的研發科學家和應用專家與客戶密切合作，為新一代的電子技術提供解決方案、產品和技術服務。這種緊密的合作關係激發了陶氏的創新發明能力，其關鍵的終端應用領域涵蓋了廣泛的消費性電子產品，包括個人電腦、電視、行動電話、全球定位系統、車輛安全系統和航空電子設備等。

媒體聯絡：

陶氏電子材料　　電話：+886-37-539158
謝嘉雯　　電郵：elysiahsieh@dow.com